

	熱処理	下地	膜厚(μm)	接触角(°)	表面硬度測定(Hv)	R. N.
Ni-P(中)	なし	なし	10	90.4	403.6	9.8
	300°C 1H			88.9	520.3	9.8
Ni-P(高)	なし	なし	10	79.7	430.7	9.5
	300°C 1H			89.1	458.6	8
テフロン無電解	なし	Ni-P(中)	10	107.9	269.2	10
	330°C 1H			110.6	397.8	9
テフロン無電解	なし	Ni-P(高)	10	107.4	250.3	10
	330°C 1H			110.3	363.2	10
無電解テフロン	なし	Ni-B	10	110.0	275.8	10
	330°C 1H			110.4	365.6	9
B-in処理	なし	Ni-P(中)	10	93.7	512.3	10
	300°C 1H			90.6	687.9	9
B-in処理	なし	Ni-P(高)	10	84.3	477.0	9.8
	300°C 1H			89.8	582.2	9.5
W-B-in	なし	Ni-P(中)	10	93.6	496.1	9.8
	300°C 1H			87.1	712.3	9
W-B-in	なし	Ni-P(高)	10	86.6	488.2	9
	300°C 1H			86.2	621.9	9
W-B-in	なし	Ni-B	10	88.4	516.1	7
	300°C 1H			85.4	679.1	7

【表面硬度測定】

測定器 アカシ製MVK-H3
測定荷重 50gf(荷重時間 20秒)

【中性塩水噴霧試験】

試験機 スガ試験機(株)製GS-IEC-S型
塩水組成 5%NaCl水溶液
噴霧温度 35°C
噴霧圧力 98KPa
試験時間 98時間
評価結果 JIS H8502 10.4.2レイティングナンバ標準図表による評価